

経営革新セミナー（2）

「AI&高密度パッケージの関係を概説します！！（製造業向け）」

1. 概要

◇テーマ：

AIは、「どんな理屈で？動作しているのか？」、「それを可能にするハードウェア（半導体チップ）は何か？その製造に要求される技術及び製造装置は何か？」を概説します。AIや半導体は日々技術革新が進んでおり、今の世の中では、知っておいて損はない内容です。皆様のご参加をお待ちしています。

◇開催日時：令和6年7月12日（金）14:00～15:00

◇会 場：①ウインクあいち（名古屋市中村区名駅4-4-38）14Fセミナールーム
②Web配信（Zoomを使用）

◇参加費用：無料

◇対 象：中小企業経営者・担当者等

◇定 員：①20名
②50名

◇主 催：公益財団法人あいち産業振興機構

2. タイムテーブル

・14:00～15:00 「AI&高密度パッケージの関係を概説します！！（製造業向け）」

【講師】（公財）あいち産業振興機構 技術・CN担当マネージャー

野上 晃

・15:00～ 個別相談会

結果報告

36名の参加申込があり、最終的に当日は31名（来訪9名・オンライン22名）の参加となりました。前半に半導体業界の全体像の説明を行い、後半にAIの出現による半導体ビジネスへの影響を俯瞰的に説明しました。特にFAや半導体装置、工作機械に係るビジネスへの影響について解説しました。

(会場風景)



(講師：(公財) あいち産業振興機構 技術・CN担当マネージャー 野上 晃)

参加者の感想

Aさん

半導体業界の動きについて、説明頂き分かりやすかったです。

Bさん

専門的な内容でしたが、分かりやすかったです。

Cさん

研修について解説していただけてよかったです。

Dさん

高密度パッケージについて専門的な話が聞けてよかったです。

以上